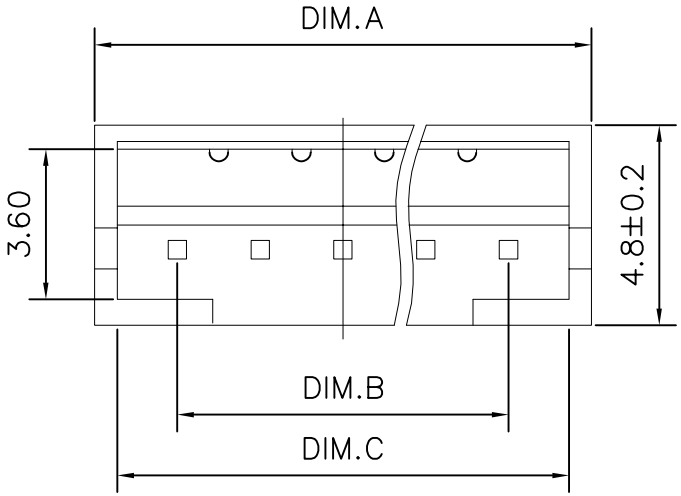
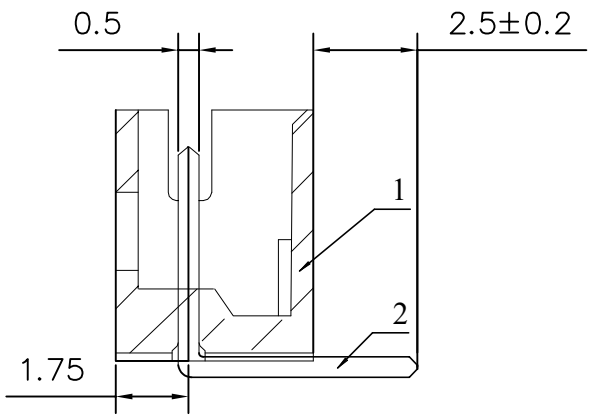
http://hcdz2017.com/

标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

Pin	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D
2	6.00	2.00	4.90	0.80
3	8.00	4.00	6.90	2.80
4	10.00	6.00	8.90	4.80
5	12.00	8.00	10.90	6.80
6	14.00	10.00	12.90	8.80
7	16.00	12.00	14.90	10.80
8	18.00	14.00	16.90	12.80
9	20.00	16.00	18.90	14.80
10	22.00	18.00	20.90	16.80
11	24.00	20.00	22.90	18.80
12	26.00	22.00	24.90	20.80
13	28.00	24.00	26.90	22.80
14	30.00	26.00	28.90	24.80
15	32.00	28.00	30.90	26.80
16	34.00	30.00	32.90	28.80





技术要求：

适应基板厚度：1.2mm~1.6mm

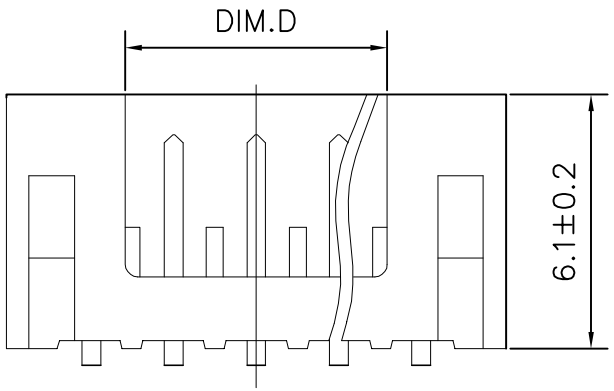
温度范围：−25℃~85℃

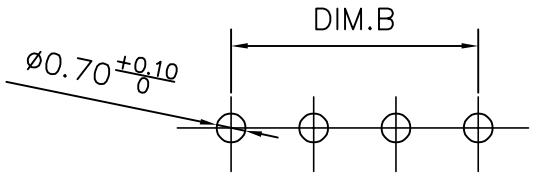
额定电压：250V AC/DC

额定电流：1A

绝缘电阻：≥1000MΩ

耐　　压：800V AC/minute





PCB LAYOUT

序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注
2	插针	铜	镀锡	
1	基座	PA66	米色	

深圳市虹成电子有限公司	品 名 TITLE	针座	
	料 号 PART NO	HCZZ0295-9	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	比 列 SCALE	1:1	
X.X ±0.35　X'. ±3.00°	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW: AhYe
X.XX ±0.25　X.X' ±2.00°	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED: 夏操云
X.XXX ±0.15　X.XX' ±1.00°	版 本 REV	A	批 准 APPROVE: 赵亮亮

http://hcdz2017.com/